

2020年7・8月号

特集：光計測の新潮流を探る

2015年3月の特集「計測技術にみる 時代はダウンサイジング」以来、O plus Eでは、光計測の特集をしていない。昨今の光計測技術である干渉計やステレオ法などの3次元形状計測技術が成熟してきていることが大きな要因である。このような状況であるが、建設業界から身近な環境計測への応用までなど新たな産業界からのニーズや新しいデバイスの登場や低価格化によって、その後、新しい技術が見受けられるようになってきた。さらには、AIを取り込んで精度向上を目指した報告も増えてきている。そこで今回の特集は、光計測の新潮流を探ると題して、産業界のニーズと新しいデバイスからのシーズを取り上げる。

	タイトル	執筆者
1	特集にあたって	O plus E 編集部
2	産業界から期待する計測の明日	住友重機械
3	分光デバイス VIPA を用いた走査を必要としない断面形状計測システム	埼玉大学
4	ソニーの偏光カメラとその環境・バイオ計測への応用	宇都宮大学
5	AI の医療画像	大阪大学
6	シングルピクセルイメージングとその応用	大阪大学
7	管状物体の内面の形状計測	住友重機械
8	機械工業における構造色と加飾の種類と評価方法	東京都立産業技術研究センター
9	建設機械の遠隔操作のための視野明瞭化	東京大学

※特集予定は都合により変更になる場合があります。